技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 第三届中国创新挑战赛（上海）组委会 | | | 机构代码 | |  | |
| 区 域 | | |  | 联系人 | 唐旭东 | | 电话 | | 13917662089 |
| 行业领域 | | |  | | | 产业领域 | |  | |
| 经济规模 | | |  | | | 人员规模 | |  | |
| **需求信息** | | | | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | ■技术研发（关键、核心技术）  ■产品研发（产品升级、新产品研发）  ■技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | 公司致力于中央空调的升级改造，现希望对AHU控制器的BACNET协议进行开发，产品主要应用于空调末端AHU（空调箱）的单体控制（温度、风道压力、风机启停、变频控制），并提供接口，可以上传至集控网络（DDC楼宇系统）或者直接利用无线物联设备进行集控。 | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）  公司致力于中央空调的升级改造，现希望对AHU控制器的BACNET协议进行开发，产品主要应用于空调末端AHU（空调箱）的单体控制（温度、风道压力、风机启停、变频控制），并提供接口，可以上传至集控网络（DDC楼宇系统）或者直接利用无线物联设备进行集控。目前有以下几点正在实施，希望能寻求外部帮助：  1.控制器的硬件部分已完成；  2.控制器的软件部分已完成；  3.目前支持485工业MODBUS协议传输至上游（组态软件或者触摸屏）；  4.下游485协议的采集（电表或变频器）---待开发和完善；  5.BACNET协议兼容；----待开发和完善。 | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）  5-10万，物联框架 | | | | | | |
| 产学研合作需求 | 需求  描述 | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） | | | | | | |
| 合作  方式 | | □技术转让 ■技术入股 ■联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 ■其他 无 | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | ■是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | ■是  □否 | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | ■是  □否 | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  ■否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | |